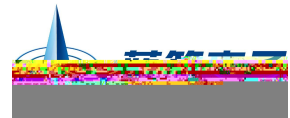


/ Revised record

版本	修订日期	有修订的页码	修订涉及的内容	拟制	审核
A	2017-11				
B	2021-2-9	2/8	SS58C的IFSM由175改为150、VF由0.7改为0.85; SS52C VF由0.45改为0.55; 更新包装规格	黄超	刘晓荣



/ Descriptions

表面贴装肖特基整流二极管，反向电压：20~200V，正向电流：5.0A，封装。

:

/ Features

低功耗，高效率，正向浪涌电流大，适用于低压高频逆变器和极性保护，适用于表面贴装，无卤产品。

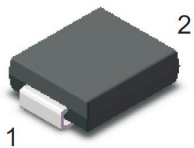
/ Applications

一般用途。

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



/ Marking

见印章说明。

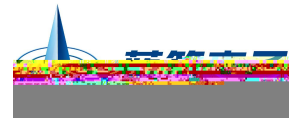
/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

参数	符号	数值								单位
	()									
										℃
										℃
										℃

)
)

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

参数	符号	测试条件	数值							单位
		℃								
		℃								

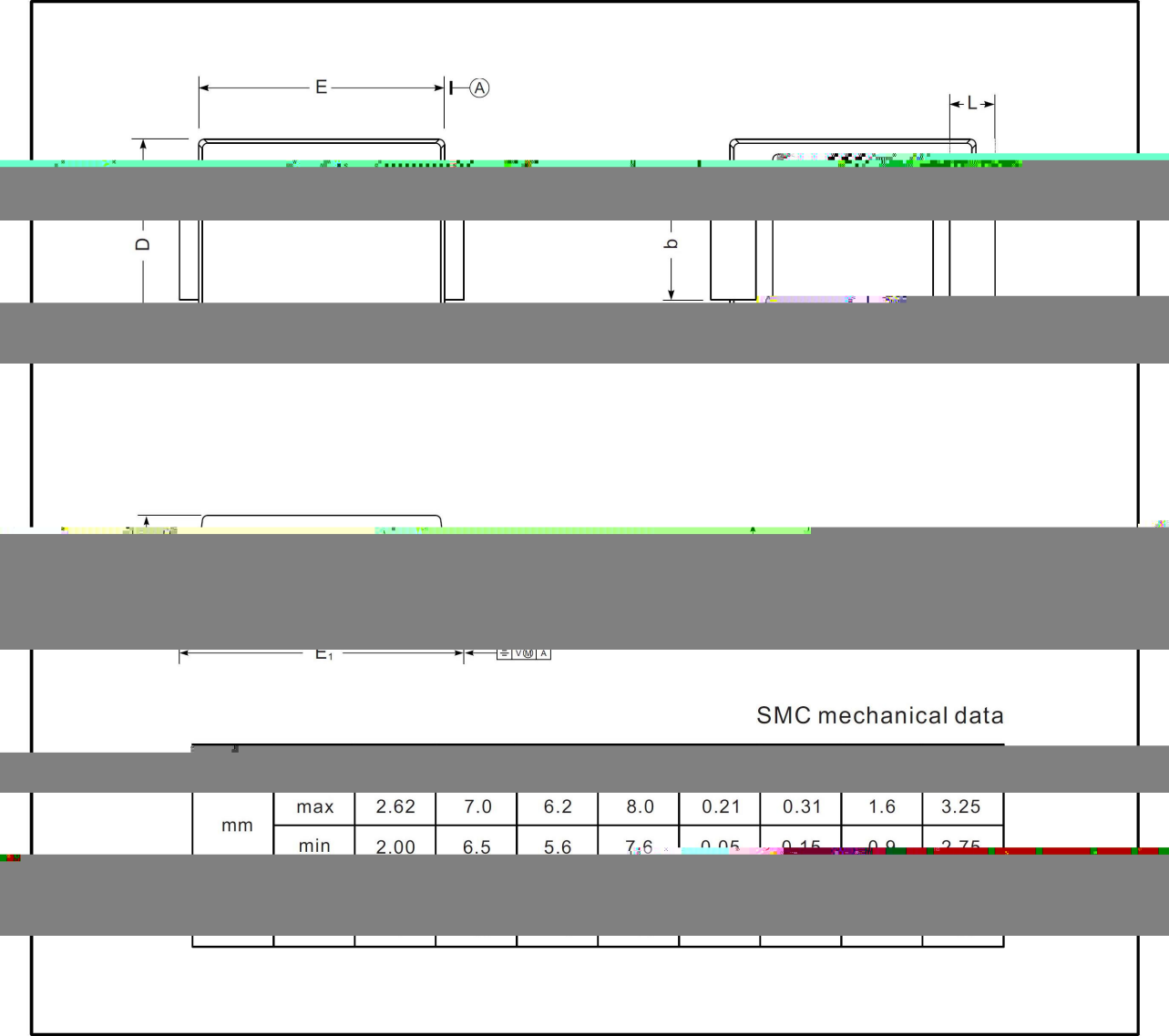


/ E



/ Package Dimensions

SMC



SMC mechanical data

mm	max	2.62	7.0	6.2	8.0	0.21	0.31	1.6	3.25	
	min	2.00	6.5	5.6	7.6	0.05	0.15	0.9	2.75	



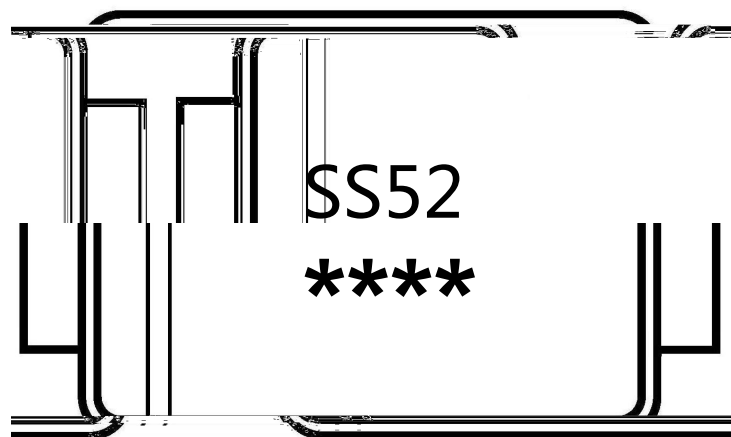
/ Marking Instructions

Marking

Type number	Marking code
SS52C	SS52C



/ Marking Instructions



说明

: 为型号代码

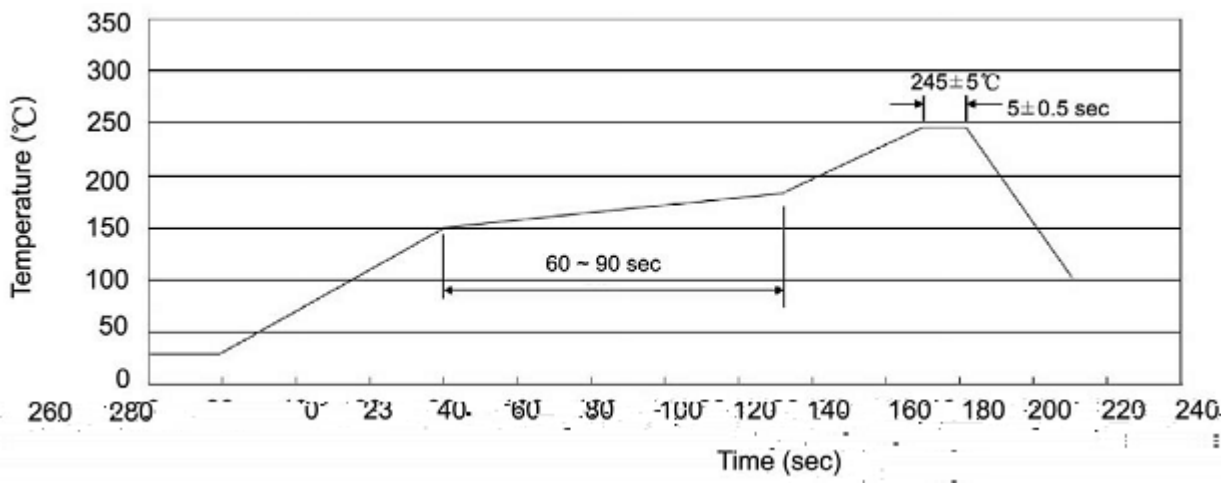
: 为生产批号追溯码，第 个 为年月代码，后面 个 为当月小批号代码

:

: , ,



() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

、预热温度 ~ °C，时间 ~ °C

、峰值温度 ± °C，时间持续为 ± °C ±

、焊接制程冷却速度为 ~ °C °C

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度： ± °C 时间： ± ± °C ±

/ Packaging SPEC.

卷盘包装

	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box	Outer Box
						"		

/ Notices